



Wafer Dicing Machine

A-WD-10B

追求されたスペースファクター、スライドカバー方式とファンクションアレンジ機能の採用により、使いやすさを実現した多用途ダイシングマシンです。

- X,Y軸のスライド部に高精度高剛性リニアガイド、Z軸駆動部にはエンコーダ付きステッピングモータの採用により高精度、高信頼性を確保
- X,Y軸の同時2軸制御及び最高速度:X軸450mm/s、Y軸80mm/s、Z軸40mm/sの高スループット
- 使いやすい位置に配置された小型操作パネル、操作性 (one hand operation) にすぐれたラバースイッチ及びジョグダイヤル、LCD採用

主な用途

- 電子部品 (SMD、HIC、圧電素子、その他)
- 半導体 (Si、GaAs、その他)
- ガラス (水晶、フィルタ、小型LCD、その他)
- サーマルヘッド (小型)、新素材



LED照明の採用により、顕微鏡画像の鮮明度及び画像認識精度を向上。(リングライト照明仕様:オプション)



株式会社東京精密



使いやすい操作部



オペレーションディスプレイ

ファンクションアレンジ機能

頻繁に使用するファンクションを登録することでショートカットによる操作性が向上します。



■ A-WD-10B 仕様

加工物サイズ	162 × 162mm	
X軸	ストローク	290mm
	切削速度	0.1～450mm/s
Y軸	ストローク	162mm
	最大速度	80mm/s
	位置決め精度	5μm
Z軸	ストローク	35mm
	送り速度	40mm/s
	分解能	0.0001mm
	θ軸	回転範囲
アライメント	顕微鏡型式	スプリットフィールド型
	カメラ、LCD	標準 (12.1"、倍率211)
スピンドル	方式	高周波ACモータ内蔵式エアスピンドル
	最大回転数	40,000min ⁻¹
	出力	900W
諸元	電源	三相 AC200～220V ±10%
	消費電力	2kVA
	エア源	0.55～0.6MPa 180ℓ/min (ANR)
	スピンドル冷却水	0.2～0.5MPa 1.5ℓ/min
	切削水	0.2～0.5MPa 最大5ℓ/min
	装置寸法、質量	650 ^W × 890 ^D × 1300 ^H mm、約500kg

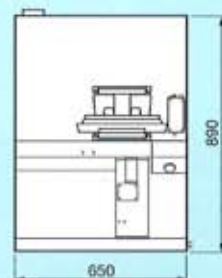
■ 主なオプション

- 非接触光学式カッターセット
- ブレード破損検出ユニット
- 3"フランジ対応
- Yスケール 位置決め精度: 2μm / 162mm
- カバーインターロック
- リングライト照明
- 中出カスピンドル
- 3色表示灯
- ミストファン
- CEマーキング
- A-CS-100A (スピンドル洗浄・乾燥機)



A-CS-100A (オプション)

フットプリント (mm)



株式会社東京精密 (お問合せはお近くの取扱店まで)

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所	(042)631-5211	(042)631-5234
大阪営業所	(06)6821-0361	(06)6821-0210
九州営業所	(097)538-1985	(097)538-1989

■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所	(022)224-0177	(022)224-7083
山形出張所	(023)631-5125	(023)625-4129
鶴岡出張所	(0235)29-8020	(0235)29-8022
会津出張所	(0242)38-2359	(0242)29-1251
東京CE課	(042)642-0358	(042)642-0367
東京CE課/土浦出張所	(0298)34-8550	(0298)31-6808
四日市出張所	(0593)61-6610	(0593)66-2210

北陸出張所	(076)422-6756	(076)422-6757
大阪CE課	(06)6821-0225	(06)6821-0210
東広島出張所	(082)493-5618	(082)493-5619
熊本出張所	(096)387-5188	(096)386-1592
九州CE課	(097)534-3291	(097)538-1989
国分出張所	(0995)43-2510	(0995)43-2586
八王子パーツセンター	(042)642-0381	(042)642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦事業所CEグループ	(029)830-1882	(029)830-1881
土浦事業所パーツセンター	(029)830-1882	(029)830-1881
名古屋事業所	(0561)32-3605	(0561)34-2744